

海通证券股份有限公司
关于杭州中欣晶圆半导体股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）



（上海市广东路 689 号）

二〇二二年八月

声 明

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（下称“《注册管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称“《上市规则》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

目 录

第一节 本次证券发行基本情况.....	3
一、本次证券发行保荐机构名称	3
二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况	3
三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员	3
四、本次保荐的发行人情况.....	4
五、本次证券发行类型	4
六、本次证券发行方案	4
七、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明	5
八、保荐机构对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见	5
第二节 保荐机构承诺事项	8
第三节 对本次证券发行的推荐意见.....	9
一、本次证券发行履行的决策程序	9
二、发行人符合科创板定位的说明	9
三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件	10
四、本次证券发行符合《注册管理办法》规定的发行条件.....	12
五、发行人私募投资基金备案的核查情况.....	16
六、发行人审计截止日后经营状况的核查结论	17
七、发行人存在的主要风险.....	17
八、发行人市场前景分析.....	19
九、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查.....	26
十、保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论	28
附件：	28
首次公开发行股票并在科创板上市的保荐代表人专项授权书.....	30

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行保荐机构名称

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“本保荐机构”）

二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况

本保荐机构指定李凌、张博文担任杭州中欣晶圆半导体股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”“中欣晶圆”）首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的保荐代表人。

李凌：本项目保荐代表人，投资银行总部执行董事，管理学硕士，具有15年投资银行从业经验，曾负责和参与了盛美上海（688082.SH）、华瓷股份（001216.SH）、新日股份（603787.SH）、岱美股份（603730.SH）、沪硅产业（688126.SH）、北京通美等IPO项目和云维股份（600725.SH）、宏源证券（000562.SZ）、云内动力（000903.SZ）、大东方（600327.SH）等再融资项目以及云内动力（000903.SZ）发行股份购买资产项目。

张博文：本项目保荐代表人，投资银行总部董事总经理。海通证券内训师，经济学硕士。2009年开始从事投资银行业务，主要负责或参与的项目包括：盛美上海（688082.SH）、沪硅产业（688126.SH）、德豪润达（002005.SZ）、长电科技（600584.SH）、恩华药业（002262.SZ）、山推股份（000680.SZ）、宁波精达（603088.SH）、科泰电源（300153.SZ）、金石东方（300434.SZ）、华瓷股份（001216.SZ）、中巨芯、北京通美等IPO、再融资及重大资产重组项目，具有丰富的投资银行实务经验。

三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员

1、项目协办人及其保荐业务执业情况

本保荐机构指定张力为本次发行的项目协办人。

张力：本项目协办人，海通证券投资银行总部副总裁，金融风险管理硕士。2017年起从事投资银行业务至今，主要参与了中芯国际、中微公司等IPO项目的发行承

销工作。

2、项目组其他成员

本次发行项目组的其他成员：席华、王来柱、李国维、王飞、金殿龙、郭毅焘。

四、本次保荐的发行人情况

公司名称	杭州中欣晶圆半导体股份有限公司
英文名称	Hangzhou Semiconductor Wafer Co., Ltd.
法定代表人	贺贤汉
股本	5,032,256,776 元
成立日期	2017 年 9 月 28 日
住所	浙江省杭州市钱塘新区东垦路 888 号
经营范围	研发、制造：高品质（功率器件、集成电路用）半导体硅片、半导体集成电路零部件、器件项目的筹建；经销自产产品并提供相关的技术咨询服务；太阳能光伏发电、售电业务；货物及技术进出口业务（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

五、本次证券发行类型

杭州中欣晶圆半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市。

六、本次证券发行方案

股票种类	人民币普通股（A 股）
每股面值	人民币 1.00 元
发行股数	本次公开发行股票的数量为不超过 167,741.90 万股，占公司发行后总股本的比例不低于 25%
发行后总股本	不超过 670,967.58 万股
定价方式	发行人和主承销商向经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者和私募基金管理人等专业机构投资者询价确定股票发行价格
发行方式	采用网下向询价对象询价配售及网上资金申购发行相结合的方式，或证券监管部门认可的其他发行方式
发行对象	符合资格的询价对象和在上海证券交易所科创板开户的自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式	余额包销
拟上市地点	上海证券交易所

七、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明

1、本保荐机构除按照交易所相关规定，将安排相关子公司参与发行人本次发行战略配售以外，本保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有本保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

3、本保荐机构的保荐代表人及其配偶、董事、监事、高级管理人员，不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况；

4、本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方不存在与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；

5、本保荐机构与发行人之间不存在其他关联关系。

八、保荐机构对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见

（一）内部审核程序

海通证券对本次发行项目的内部审核经过了立项评审、申报评审及内核三个阶段。

1、立项评审

本保荐机构以保荐项目立项评审委员会（以下简称“立项评审会”）方式对保荐项目进行审核，评审会委员依据其独立判断对项目进行表决，决定项目是否批准立项。具体程序如下：

（1）凡拟由海通证券作为保荐机构向中国证监会、上海证券交易所推荐的证券发行业务项目，应按照《海通证券股份有限公司保荐项目立项评审实施细则》之规定进行立项。

（2）项目组负责制作立项申请文件，项目组的立项申请文件应经项目负责人、分管领导同意后报送质量控制部；由质量控制部审核出具审核意见并提交立项评审

会审议；立项评审会审议通过后予以立项。

(3) 获准立项的项目应组建完整的项目组，开展尽职调查和文件制作工作，建立和完善项目尽职调查工作底稿。

2、申报评审

本保荐机构以保荐项目申报评审委员会（以下简称“申报评审会”）方式对保荐项目进行审核，评审会委员依据其独立判断对项目进行表决，决定项目是否提交公司内核。具体程序如下：

(1) 项目组申请启动申报评审程序前，应当完成对现场尽职调查阶段工作底稿的获取和归集工作，并提交质量控制部验收。底稿验收通过的，项目组可以申请启动申报评审会议审议程序。

(2) 项目组在发行申请文件制作完成后，申请内核前，需履行项目申报评审程序。申报评审由项目组提出申请，并经保荐代表人、分管领导审核同意后提交质量控制部，由质量控制部审核出具审核意见并提交申报评审会审议。

(3) 申报评审会审议通过的项目，项目组应及时按评审会修改意见完善发行申请文件，按要求向内核部报送内核申请文件并申请内核。

3、内核

内核部为本保荐机构投资银行类业务的内核部门，并负责海通证券投资银行类业务内核委员会（以下简称“内核委员会”）的日常事务。内核部通过公司层面审核的形式对投资银行类项目进行出口管理和终端风险控制，履行以公司名义对外提交、报送、出具或披露材料和文件的最终审批决策职责。内核委员会通过召开内核会议方式履行职责，决定是否向中国证监会、上海证券交易所推荐发行人股票、可转换债券和其他证券发行上市，内核委员根据各自职责独立发表意见。具体工作流程如下：

(1) 投资银行业务部门将申请文件完整报送内核部门，材料不齐不予受理。应送交的申请文件清单由内核部门确定。

(2) 申请文件在提交内核委员会之前，由内核部门负责预先审核。

(3) 内核部门负责将申请文件送达内核委员，通知内核会议召开时间，并由内核委员审核申请文件。

(4) 内核部门根据《海通证券股份有限公司投资银行类项目问核制度》进行问核。

(5) 召开内核会议，对项目进行审核。

(6) 内核部门汇总整理内核委员审核意见，并反馈给投资银行业务部门及项目人员。

(7) 投资银行业务部门及项目人员回复内核审核意见并根据内核审核意见进行补充尽职调查（如需要），修改申请文件。

(8) 内核部门对内核审核意见的回复、落实情况进行审核。

(9) 内核委员独立行使表决权并投票表决，内核机构制作内核决议，并由参会内核委员签字确认。

(10) 内核表决通过的项目在对外报送之前须履行公司内部审批程序。

(二) 内核委员会意见

2022年8月12日，本保荐机构内核委员会就杭州中欣晶圆半导体股份有限公司申请首次公开发行股票并在科创板上市项目召开了内核会议。内核委员会经过投票表决，认为发行人申请文件符合有关法律、法规和规范性文件中关于首次公开发行股票并在科创板上市的相关要求，同意推荐发行人股票发行上市。

第二节 保荐机构承诺事项

本保荐机构承诺：

一、本保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐发行人证券发行上市，并据此出具本发行保荐书。

二、本保荐机构通过尽职调查和对申请文件的审慎核查：

1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会、上海证券交易所有关证券发行上市的相关规定；

2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

6、保证发行保荐书与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；

9、中国证监会规定的其他事项。

第三节 对本次证券发行的推荐意见

一、本次证券发行履行的决策程序

本保荐机构对发行人本次发行履行决策程序的情况进行了逐项核查。经核查，本保荐机构认为，发行人本次发行已履行了《公司法》、《证券法》及《注册管理办法》等中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序，具体情况如下：

1、董事会审议过程

2022年3月18日，发行人召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于本公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在上海证券交易所科创板上市的议案》《关于授权本公司董事会全权办理首次公开发行人民币普通股股票并在上海证券交易所科创板上市有关事宜的议案》《关于本公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在上海证券交易所科创板上市募集资金用途的议案》等与本次发行上市相关的议案。

2、股东大会审议过程

2022年4月2日，发行人召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了上述与本次发行上市相关的议案。

二、发行人符合科创板定位的说明

1、发行人符合科创板行业领域要求

公司所属行业领域	<input checked="" type="checkbox"/> 新一代信息技术	公司属于中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》之“计算机、通信和其他电子设备制造业（分类代码：C39）”及国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）之“计算机、通信和其他电子设备制造业”下的“电子元件及电子专用材料制造”（C398），为国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》规定的鼓励类产业。根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018年版）》，公司主要产品及服务属于：1 新一代信息技术产业-1.2 电子核心产业-1.2.3 高储能和关键电子材料制造和 3.4.3.1 半导体晶体制造。
	<input type="checkbox"/> 高端装备	
	<input type="checkbox"/> 新材料	
	<input type="checkbox"/> 新能源	
	<input type="checkbox"/> 节能环保	
	<input type="checkbox"/> 生物医药	
	<input type="checkbox"/> 符合科创板定位的其他领域	

2、发行人符合科创属性要求的核查情况

科创属性评价标准一	是否符合	指标情况
最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入比例 $\geq 5\%$ ，或最近三年累计研发投入金额 $\geq 6,000$ 万元	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2019年、2020年和2021年公司累计研发投入为21,573.91万元，占最近三年累计营业收入163,497.17万元的比例为13.20%，符合《科创属性评价指引（试行）》第一条第（1）款的要求。
研发人员占当年员工总数的比例不低于10%	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2021年末，公司研发人员占员工总数比例为10.99%，符合《科创属性评价指引（试行）》第一条第（2）款的要求。
形成主营业务收入的发明专利（含国防专利） ≥ 5 项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	截至2022年6月30日，公司拥有已获授权的发明专利32项；2019年度至2021年度，发行人核心技术产品收入占营业收入比例分别为98.57%、98.16%、99.34%，公司符合《科创属性评价指引（试行）》第一条第（3）款的要求。
最近三年营业收入复合增长率 $\geq 20\%$ ；或最近一年营业收入金额 ≥ 3 亿元	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2019年、2020年和2021年，公司营业收入分别为38,654.57万元、42,512.05万元和82,330.55万元，复合增长率为45.94%，且最近一年营业收入金额 > 3 亿元。公司符合《科创属性评价指引（试行）》第一条第（4）款的要求。

3、核查意见

根据《科创板注册管理办法》《科创板审核规则》《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》《科创属性评价指引（试行）》等有关规定，公司符合科创属性和科创板定位要求。

三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件

本保荐机构对发行人符合《证券法》关于首次公开发行新股条件的情况进行了逐项核查。经核查，本保荐机构认为发行人本次发行符合《证券法》规定的发行条件，具体情况如下：

1、发行人具备健全且运行良好的组织机构

发行人《公司章程》合法有效，股东大会、董事会、监事会和独立董事制度健全，能够依法有效履行职责；发行人具有经营所需的职能部门且运行良好。

发行人具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十二条第一款第（一）

项的规定。

2、发行人具有持续经营能力

报告期内，发行人分别实现营业收入38,654.57万元、42,512.05万元、82,330.55万元和70,168.94万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为-17,102.50万元、-45,004.75万元、-34,415.07万元和-10,535.04万元。公司8英寸、12英寸硅片生产线为近年新建且处于产能爬坡过程中，持续处于客户开拓过程中，产品品质继续优化，上述产品生产线陆续投产，相应的机器设备转固，导致固定成本较高。因此，公司8英寸、12英寸硅片整体处于亏损状态，使得公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为负，母公司未分配利润为负。

截至2022年6月30日，公司流动资产为350,139.68万元，流动负债为159,750.95万元，公司所有者权益合计806,096.62万元，公司流动性良好。报告期各期末，公司合并口径资产负债率分别为53.57%、43.64%、24.36%和26.13%，偿债指标持续改善。经过多年的技术开发和客户积累，公司奠定了较高的技术地位及市场地位，市场对公司的认可程度不断提升。公司通过各渠道的融资能力有所增强，主要融资来源包括股权融资及银行借款等。截至2022年6月30日，公司货币资金为236,847.18万元，具备一定规模的资金储备，可以满足公司正常运营的资金需求，不存在逾期未偿还、无法继续履行重大借款合同中的有关条款、无法获得研发所需资金等严重影响公司持续经营能力的情况。

公司最近一期尚未实现盈利且存在未弥补亏损，但具备较高的客户认可度及市场地位，且报告期内销售规模持续扩大，综合毛利率水平得到改善，息税折旧摊销前利润于2021年转正，毛利于2022年上半年转正，预计未来将实现盈利并收窄未弥补亏损缺口。在销售收入快速增长及各渠道融资的支持下，公司各经营环节运作良好，预计未来能够进行持续性的业务拓展、人才吸引、研发及战略性投入，并有能力确保团队稳定性和生产经营可持续性。

发行人具有持续经营能力，符合《证券法》第十二条第一款第（二）项的规定。

3、发行人最近三年及一期财务会计报告被出具无保留意见审计报告

天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对发行人最近三年及一期的财务报告出具了无保留意见的审计报告，认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日和2022年6月30日的合并及公司财务状况以及2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-6月的合并及公司经营成果和现金流量。

发行人最近三年及一期财务会计报告被出具无保留意见审计报告，符合《证券法》第十二条第一款第（三）项的规定。

4、发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪

发行人无实际控制人，根据各有权机构出具的证明文件，发行人及其控股股东最近三年认真执行国家及地方有关法律、法规，无重大违法行为，不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪。

发行人符合《证券法》第十二条第一款第（四）项的规定。

综上所述，本保荐机构认为发行人符合《证券法》规定的发行条件。

四、本次证券发行符合《注册管理办法》规定的发行条件

本保荐机构根据《注册管理办法》对发行人及本次发行的相关条款进行了逐项核查。经核查，本保荐机构认为，发行人本次发行符合中国证监会关于首次公开发行股票并在科创板上市的相关规定。本保荐机构的结论性意见及核查过程和事实依据的具体情况如下：

（一）发行人的主体资格

发行人是依法设立且持续经营3年以上的股份有限公司，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责。

有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，持续经营时间可以从有限责任公司成立之日起计算。

本保荐机构调阅了发行人的工商档案、营业执照等有关资料，2017年9月15日，

日本磁性控股、杭州热磁及上海申和共同签署《杭州中芯晶圆半导体股份有限公司发起人协议书》发起设立杭州中芯晶圆半导体股份有限公司（发行人曾用名）。同日，发行人召开首次股东大会（创立大会），审议通过了《杭州中芯晶圆半导体股份有限公司成立工作报告及议案》《杭州中芯晶圆半导体股份有限公司章程》等议案，并选举产生了发行人第一届董事会成员和第一届监事会股东代表监事。

发行人设立时的注册资本为290,000万元。2017年9月28日，发行人经杭州市市场监督管理局核准设立并取得统一社会信用代码为91330100MA2AX8UL47的《营业执照》。2017年10月19日，发行人在杭州大江东产业集聚区行政审批局办理了外商投资企业设立备案，并取得了备案回执。

综上，发行人是依法设立、有效存续并已持续经营三年以上的股份有限公司，符合《注册管理办法》第十条的规定。

（二）发行人的财务与内控

发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由注册会计师出具无保留意见的审计报告。

发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具无保留结论的内部控制鉴证报告。

1、本保荐机构查阅了发行人相关财务管理制度，确认发行人会计核算工作规范；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》，发行人财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了发行人报告期内财务状况、经营成果、现金流量。符合《注册管理办法》第十一条第一款之规定。

2、本保荐机构查阅了发行人内部控制制度，确认发行人内部控制在所有重大方面是有效的。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于杭州中欣晶圆半导体股份有限公司内部控制的鉴证报告》，认为公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2022年6月30日在所有重大方面保持了有效的内部控制，符合《注册管

理办法》第十一条第二款之规定。

（三）发行人的持续经营

发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力：

1、资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

本保荐机构深入了解发行人的商业模式，查阅了发行人主要合同、通过实地走访和视频等方式访谈了主要客户及供应商，与发行人高级管理人员、主要职能部门负责人和主要股东进行了访谈，了解了发行人的组织结构、业务流程和实际经营情况。确认发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，与主要股东及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。经核查，发行人资产完整、人员、财务、机构及业务独立，符合《注册管理办法》第十二条第一款之规定。

2、发行人主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定，最近 2 年内主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化；控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，最近 2 年实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。

本保荐机构查阅了发行人公司章程、历次董事会、股东大会决议和记录，查阅了工商登记文件，查阅了发行人财务报告，确认发行人主营业务、管理团队和核心技术人员稳定；最近 2 年内主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化；主要股东和受主要股东支配的股东所持发行人的股份权属清晰，最近 2 年实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。发行人符合《注册管理办法》第十二条第二款之规定。

3、发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生的重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项。

本保荐机构查阅了发行人主要资产、核心技术、商标等的权属文件，确认发行人主要资产、核心技术、商标等权属清晰，不存在重大权属纠纷的情况。保荐机构向银行取得了发行人担保的相关信用记录文件，核查了发行人相关的诉讼和仲裁文件，发行人不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项。

本保荐机构查阅分析了相关行业研究资料、行业分析报告及行业主管部门制定的行业发展规划等，访谈了发行人高级管理人员，核查分析了发行人的经营资料、财务报告和审计报告等，确认不存在经营环境已经或者将要发生重大变化等对发行人持续经营有重大不利影响的事项。发行人符合《注册管理办法》第十二条第三款之规定。

（四）发行人的规范运行

1、发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策。

本保荐机构查阅了发行人《公司章程》，查阅了所属行业相关法律法规和国家产业政策，查阅了发行人生产经营所需的各项政府许可、权利证书或批复文件等，实地查看了发行人生产经营场所，确认发行人主要经营范围为：研发、制造：高品质（功率器件、集成电路用）半导体硅片、半导体集成电路零部件、器件项目的筹建；经销自产产品并提供相关的技术咨询服务；太阳能光伏发电、售电业务；货物及技术进出口业务（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。发行人的生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业政策。因此发行人符合《注册管理办法》第十三条第一款之规定。

2、最近3年内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

董事、监事和高级管理人员不存在最近3年内受到中国证监会行政处罚，或者

因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形。

本保荐机构取得了发行人、控股股东关于违法违规情况的说明以及发行人无实际控制人的说明，获取了相关部门出具的证明文件，确认发行人、控股股东不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。因此发行人、控股股东符合《注册管理办法》第十三条第二款之规定。

本保荐机构查阅了中国证监会、证券交易所的公告，访谈发行人董事、监事和高级管理人员，取得了相关人员的声明文件，确认发行人董事、监事和高级管理人员不存在最近3年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形。因此，发行人符合《注册管理办法》第十三条第三款之规定。

五、发行人私募投资基金备案的核查情况

经本保荐机构核查，截至本发行保荐书出具日，发行人股东嘉善嘉和股权投资合伙企业（有限合伙）、共青城兴橙东樱半导体产业投资合伙企业（有限合伙）、杭州国改立春股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴临智股权投资合伙企业（有限合伙）、厦门建发新兴产业股权投资贰号合伙企业（有限合伙）、共青城欣睿创业投资合伙企业（有限合伙）、上海云锋麒泰投资中心（有限合伙）、嘉兴海松之峰股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴建自壹号股权投资合伙企业（有限合伙）、厦门昆仑雪坡壹号股权投资合伙企业（有限合伙）、浙江丽水两山股权投资合伙企业（有限合伙）、浙江深改产业发展合伙企业（有限合伙）、交银舜晶（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区星棋道和股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州普华硕阳股权投资合伙企业（有限合伙）、厦门昆仑雪坡叁号股权投资合伙企业（有限合伙）、青岛民芯启元投资中心（有限合伙）、青岛民蕊投资中心（有限合伙）、泉州常弘星晨股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州珉澜股权投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门昆仑雪坡贰号股权投资合伙企业（有限合伙）、

长三角（嘉善）股权投资合伙企业（有限合伙）、厦门斐昱萤芯壹号投资合伙企业（有限合伙）、杭州津泰股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴芯荣股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市瑞兆高精尖八期投资合伙企业（有限合伙）、安吉锦荣股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴德桥临芯股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州平毅创业投资合伙企业（有限合伙）、湖州瑗沐股权投资合伙企业（有限合伙）、龙岩昊嘉创业投资合伙企业（有限合伙）、广东联塑守正创业投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴晶凯贤信股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴宏万耘凌股权投资合伙企业（有限合伙）、中小企业发展基金浙普（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）、昆山双禺启航股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴云盛创世股权投资合伙企业（有限合伙）、尚融创新（宁波）股权投资中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区星樾股权投资合伙企业（有限合伙）、福州经济技术开发区启浦晨舜股权投资合伙企业（有限合伙）、济南鼎量通元投资合伙企业（有限合伙）、湖州鼎齐股权投资合伙企业（有限合伙）、欠发达地区产业发展基金有限公司、中央企业乡村产业投资基金股份有限公司、台州盛今股权投资合伙企业(有限合伙)、宜兴东证睿元股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州中金上汽新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中金祺智(上海)股权投资中心(有限合伙)、诸暨东证临杭股权投资合伙企业(有限合伙)、诸暨东证睿坤股权投资合伙企业(有限合伙)50名股东属于为私募基金规则所规范的私募投资基金，上述主体均已完成基金管理人登记及私募投资基金备案的手续。

六、发行人审计截止日后经营状况的核查结论

经核查，保荐机构认为：财务报告审计截止日至本发行保荐书出具日，发行人经营状况良好，发行人经营模式、主要原材料的采购规模和采购价格、主要生产模式、销售规模及销售价格、主要客户及供应商的构成、主要税收政策等方面均未发生重大变化，不存在其他可能影响投资者判断的重大事项。

七、发行人存在的主要风险

（一）公司尚未盈利且存在继续亏损的风险

报告期内，公司的营业收入分别为38,654.57万元、42,512.05 万元、82,330.55 万元和70,168.94万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为-17,102.50万元、-45,004.75万元、-34,415.07万元和-10,535.04万元，均为负值。由于公司固定资产投资较大，且8英寸、12英寸硅片生产线正式投产时间较短，部分目标客户仍处于开拓过程中，预计未来仍存在亏损的风险。

如果公司持续亏损且无法通过外部途径进行融资，将会造成公司现金流紧张，进而对公司业务拓展、人才引进、团队稳定、研发投入、市场拓展等方面造成负面影响。

（二）母公司存在累计未弥补亏损的风险

截至2022年6月30日，公司经审计的母公司报表未分配利润为-39,926.44万元，合并报表中未分配利润为-102,665.22万元，可供股东分配的利润为负值。

若公司不能尽快实现盈利，在短期内将无法完全弥补累积亏损。在首次公开发行股票并在科创板上市后，公司将存在短期内无法向股东现金分红并由新老股东共同承担累计未弥补亏损的风险，将对股东的投资收益造成不利影响。

（三）客户认证风险

芯片制造企业对半导体硅片的品质有着极高的要求，对供应商的选择非常慎重。根据行业惯例，半导体硅片产品通过下游企业的认证是双方建立合作关系、实现销售的必要条件。产品认证需花费3个月至2年，甚至更长的时间，产品认证时间长短随产品用途、客户认证要求的不同而有所区别。产品认证通过后，经与客户签订订单或合同，公司可正式向客户销售符合质量要求的产品。公司的8英寸、12英寸硅片生产线正式投产时间较短，部分目标客户仍处于产品认证阶段。若公司的8英寸、12英寸硅片未能及时获得重要目标客户的认证，将对公司的经营造成不利影响。

（四）固定资产投资风险

公司所处的半导体硅片行业属于典型的资本密集型行业，固定资产投资的需求较高，尤其是半导体硅片生产制造所需的晶体生长设备、抛光设备、外延设备、检

测设备等关键设备的购置成本高昂，规模化生产所需的生产线建设投入巨大。截至2022年6月30日，公司固定资产账面价值为461,951.37万元、在建工程账面金额为253,275.16万元。同时，公司还在进行12英寸半导体硅片生产线项目后续投入以及丽水中欣半导体外延片项目的投入。为了保持竞争力，公司未来可能继续增加产能，将导致固定资产规模继续扩大。

此外，半导体硅片的生产线建设从设备调试、产品认证到批量生产，需要不断对制造工艺和技术参数进行调试。因此，半导体硅片的生产线从投产至达到设计产能，需要经历较长的周期。若公司营收规模的增长无法消化大额固定资产投资带来的新增折旧，公司将面临业绩下降的风险。

（五）涉及诉讼的风险

截至本发行保荐书出具日，公司存在尚未了结的诉讼事项。其中，公司作为被告的诉讼事项主要包括：1、中建一局诉中欣晶圆建设工程施工合同纠纷案，该案包含土建合同及机电合同，中建一局诉讼请求公司支付工程款36,186.99万元及相应利息，该案尚在一审程序中。针对该诉讼事项，公司已提起反诉；2、亚翔集成诉讼中欣晶圆建设工程施工合同纠纷案，一审判决公司向亚翔集成支付工程款10,913.08万元及相应利息；二审裁定撤销一审判决、发回重审。目前该案尚在审理过程中。

对于上述诉讼，公司已经根据案件情况计提了预计负债，存在最终判决作出后预计负债计提金额不足、需履行额外支付义务的风险。

（六）国际贸易争端加剧及半导体相关材料和设备进口受限的风险

2018年以来，国际局势跌宕起伏，中国大陆面临的国际贸易环境有所恶化。2022年，美国进一步出台了《芯片与科学法案》等政策，限制向中国大陆出口先进制程相关的半导体生产设备。公司生产所需的原材料和生产设备主要采购自境外，部分产品销往境外。如果未来中国大陆国际贸易争端进一步加剧，不排除美国及其他国家或地区进一步收紧向中国大陆出口半导体相关原材料和生产设备的限制，提高对中国大陆半导体硅片产品的进口关税，甚至限制中国大陆半导体硅片在该国家或地区的销售。如该等情形发生，将对公司的原材料采购、设备采购及产品销售造成不利影响，从而影响公司的生产经营和业务扩张。

八、发行人市场前景分析

（一）发行人的竞争优势和劣势

1、竞争优势

（1）技术优势

公司一直专注于半导体硅片产品的技术研发与工艺提升，始终坚持创新并积极将先进技术运用于生产中。公司已经建立了来自韩国、中国大陆以及中国台湾地区等国家或地区学科背景齐全、行业经验丰富的研发人才梯队，为公司持续创新、保持技术先进性提供人才保障。

经过多年的持续研发和生产实践，公司形成了深厚的技术积累和工艺积淀。公司已掌握 8 英寸和 12 英寸 COP-Free 晶体生长技术、12 英寸重掺砷低阻晶体生长技术、单晶硅棒二次投料装置技术、8 英寸和 12 英寸高平坦度硅片切割技术、硅片自旋转双面研磨技术和边缘研磨技术、提高半导体硅片端面腐蚀能力的腐蚀方法、边缘抛光和表面抛光技术、硅片外延技术等半导体抛光片和外延片制造流程的关键技术。公司在掌握 8 英寸及以下半导体硅片技术的基础上，通过持续研发掌握了 12 英寸半导体硅片的核心技术。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司共拥有已获授权的专利 154 项，其中发明专利 32 项，结合掌握的多项技术秘密，形成了晶体生长、单晶硅棒切片、研磨、化学腐蚀、抛光、外延、检测等各环节的核心技术体系。同时，公司亦在高平坦度硅片生产工艺以及超低电阻率单晶和低含氧量单晶的开发等领域进行了技术储备。

公司通过不断的研发投入和技术、工艺积累，利用差异化竞争和创新的发展战略，在行业竞争中拥有一定的技术优势。

（2）产品优势

公司产品规格齐全，包括 4 英寸、5 英寸、6 英寸、8 英寸、12 英寸半导体抛光片以及 12 英寸半导体外延片。公司拥有完整的半导体硅片制备工艺和全尺寸的硅片生产线，可实现从晶体生长、切片、研磨、抛光到外延的全链条生产。公司的半导体硅片产品具有高平整度、高均匀性、低缺陷密度等特点，平坦度、翘曲度、厚度、表面颗粒、表面金属含量、电阻率梯度等技术指标具有领先优势。

此外，公司在宁夏银川建立了 4-12 英寸半导体晶体生长工厂，为上海中欣以及杭州中欣供应单晶硅棒，保证了硅片生产的安全性和稳定性；同时公司掌握成熟、可靠、先进的晶体生长技术和半导体硅片切片、研磨、抛光技术，可提高硅片生产过程中工艺设计的灵活性，用于生产不同规格、种类的半导体硅片产品，同时还可以积极响应客户的定制化生产需求以满足下游客户的新产品开发和迭代需求。

（3）质量控制优势

公司高度重视产品质量，始终坚持产品质量是公司核心竞争力之一，为此公司制定了严格的产品品质管理体系，且已通过 IATF 16949:2016 质量管理体系认证、ISO9001:2015 质量管理体系认证、ISO14001:2015 环境管理体系认证和 ISO45001:2018 职业健康安全管理体系认证。

公司质量控制优势体现在公司生产管理的各个环节。公司遵照上述管理体系标准形成了以品质部为核心，生产管理部、采购中心、人事部门和技术部门协同配合的质量控制架构，制定了覆盖客户要求应对、产品设计与开发、产品生产与交付及客户满意度评价等质量控制流程，并在实际生产经营过程中严格执行，以确保公司产品保持良好的一致性和稳定性，能够持续满足客户对产品质量不断提升的要求。

此外，公司通过制定 3-5 年长期质量控制发展规划、按年分解质量控制目标的方式，为保持公司质量控制优势、不断提升产品质量提供了保障。

（4）生产管理优势

日本磁性控股在半导体领域拥有长期的、成熟的、经过实践检验的生产管理经验，在中国大陆拥有多家行业领先的半导体材料企业。公司吸收了日本磁性控股在生产管理上的经验，推行标准化、可视化、数字化、自动化工作理念，全面实现智能化、网联化、视频化、远程化管理，公司被评为 2021 年度杭州市“智能工厂”企业。

公司依托企业资源管理系统（ERP）和制造执行系统（MES）的融合，通过引入基本信息管理模块、生产过程管理模块、生产设备监控模块和现场监控模块等子系统，将公司的自动化生产设备、自动包装系统和全自动搬运 OHT 系统融入到生产管理中，提高了对生产车间内物资流转的控制和生产时间的可计算性。ERP 和

MES 的融合，将财务、技术、采购、生产和销售等多部门统一管理，实现了企业生产管理的全面信息化，提升了公司生产管理优势。

此外公司的存货管理制度、采购管理制度等生产管理配套制度，搭配 6S（整理、整顿、清扫、清洁、安全、素养）管理要求，可减少车间人员、物料、机器设备等在时间与空间上的浪费，提高生产效率的稳定性和生产品质的一致性。

（5）客户优势

公司产品已进入台积电、环球晶圆、客户 A、士兰微、沪硅产业、汉磊科技、长江存储、青岛芯恩、合肥晶合、绍兴中芯、Fuji Electric、Toshiba 等下游知名半导体企业。同时，公司持续开拓新客户，已经向境内外多家一线晶圆制造企业开展产品送样和认证，客户认证进度符合预期。

晶圆制造企业与半导体硅片供应商的粘性较高，对供应商的甄选和管理较为严格。通常情况下，下游客户选择供应商之前，通常需要经过送样小试、中试、大试、小量、中量、量产等严格复杂的产品认证程序，认证周期较长。且出于对产品性能的稳定性和一致性要求，在选择好供应商后，通常不会轻易更换。因此，公司已经与下游知名半导体企业建立了良好的合作关系，形成了较为明显的客户优势。

（6）供应链优势

半导体硅片制造对原材料和设备的要求较高，尤其是大尺寸硅片生产所需的研磨机、切割机、抛光机、外延炉等设备以及半导体级多晶硅、特殊包装材料等原材料均大量依赖于进口。公司在间接控股股东日本磁性控股的协助下自主建立了覆盖全球范围的供应链体系，与多家日本、美国、欧洲等国家或地区的半导体设备供应商和原材料供应商建立了良好的合作关系，保证了原材料的稳定性以及生产设备的先进性。同时，公司制定了严格的采购管理制度，从采购标准、供应商选择、具体采购方式等方面保障了原材料符合质量要求。

此外，日本磁性控股旗下的半导体设备和材料企业可提供具有国际竞争力的设备或材料，如上海汉虹为中国大陆少数可以生产大尺寸半导体单晶炉的厂家，与有研半导体、上海超硅半导体有限公司等中国大陆半导体硅片制造商保持稳定合作关系；盾源聚芯为行业领先的石英坩埚和硅零部件制造商，其产品同时销往全球排名

前五的半导体硅片制造商 SUMCO、环球晶圆、Siltronic AG、SK Siltron；杭州热磁和富乐德石英占据全球 8 英寸、12 英寸集成电路用石英市场的主要份额，产品销往 Tokyo Electron Limited（日本东京电子）和沪硅产业、立昂微等境内外知名企业厂商。上述供应商为公司生产高品质产品、持续提升产品品质以及保障生产经营的稳定性提供了良好的支撑，在公司当前持续扩大产能的背景下，公司拥有显著的供应链优势。

（7）协同经营优势

公司在浙江杭州、上海、宁夏银川、浙江丽水设立了生产基地，并在日本设立了子公司。宁夏中欣依托宁夏银川当地的能源优势开展单晶硅棒生产；杭州中欣及上海中欣开展后续硅片的研磨、抛光等生产环节；丽水中欣专门从事外延片的研发、生产和销售；日本中欣为公司境外采购和境外销售平台，可以保证公司稳定的境外采购，并起到拓展境外销售业务的支点作用。

杭州中欣、上海中欣及丽水中欣地处中国长三角经济区，伴随长三角地区在半导体产业逐渐形成的产业集聚效应，更多境内外晶圆代工厂商、IDM 厂商在长三角地区进行研发或生产布局，使得公司可以更接近下游客户。

公司已完成了采购、生产、销售等环节的协同布局，各类核心原辅材料能得到更可靠的供应，生产更具有稳定性和灵活性，销售更接近下游客户，拥有显著的协同经营优势。

2、竞争劣势

（1）大尺寸硅片的后发劣势

半导体硅片是芯片制造的核心材料，芯片制造企业对半导体硅片的稳定性及一致性等品质有着极高的要求，对供应商的选择非常慎重。根据行业惯例，芯片制造企业需要先对半导体硅片产品进行认证，才会将该硅片制造企业纳入供应链，一旦认证通过，芯片制造企业也不会轻易更换供应商，对硅片制造企业的粘性较强，不利于新的硅片制造企业进入客户供应链。公司大尺寸硅片的生产与销售晚于全球龙头半导体硅片制造企业和部分中国大陆半导体硅片供应商，还存在大量正在产品认证中的客户，尚无法对正在认证中客户实现批量销售。

（2）尚未完全体现规模效应，新设备折旧成本高

虽然公司已经是国内先进的半导体硅片企业，但与国际领先企业相比，在生产上尚未完全体现规模效应。

公司固定资产投资的需求较高，尤其是半导体硅片生产制造所需的晶体生长设备、抛光机、外延设备、检测设备等关键设备的购置成本高昂，规模化生产所需的生产线建设投入巨大。此外，半导体硅片的生产线建设从设备调试、产品认证到批量生产，需要不断对制造工艺和技术参数进行调试，半导体硅片的生产线从试生产到满足设计产能，需要经历较长的周期。在此期间，公司生产成本受高额设备折旧的影响较大。

（3）现有融资渠道难以满足快速增加的资金需求

公司所处的半导体硅片行业是资本密集型行业，建设生产线以及持续研发需要投入大量的资金。公司竞争对手普遍为上市公司，融资渠道丰富。公司需顺应半导体硅片行业的发展，不断提高工艺水平、优化产品结构、扩大生产能力，由此带来较大的资金需求。近年随着公司经营规模的快速扩大，资金一直是制约公司发展的主要瓶颈之一，目前公司的融资渠道难以满足快速增加的资金需求，限制了公司的快速发展。

公司拟通过本次公开发行股票，增强资金实力，并在落实募集资金投资项目的同时，加大研发投入，增强公司研发实力。

（二）行业发展态势与面临的机遇

（1）全球半导体行业区域转移

全球半导体产业链历史上曾经历过两次地域上的产业转移，第一次为 20 世纪 70 年代从美国向日本转移，第二次是 20 世纪 80 年代从美国、日本向韩国和中国台湾地区转移。目前，全球半导体产业正处于向中国大陆地区转移的进程之中半导体材料行业作为半导体产业的主要支撑性行业有望持续增长。

在半导体产业向中国大陆转移的背景下，中国大陆作为全球最大的半导体终端应用市场，将有望吸引更多境内外半导体企业在中国大陆建厂，将进一步提升国内半导体材料产业链的整体发展水平，中国大陆半导体硅片需求将不断增长。

（2）国家产业政策的有力支持

半导体硅片行业属于半导体行业的细分行业，为国家重点鼓励扶持的战略性新兴产业。近年来国家和各级地方政策不断出台针对集成电路产业的鼓励和支持政策。2014 年国务院出台了《国家集成电路产业发展推进纲要》，着力推动中国集成电路产业的发展，在关键材料领域形成突破，开发大尺寸硅片等关键材料，加快产业化进程，增强产业配套能力；2017 年工信部出台的《新材料产业发展指南》，明确提出加强大尺寸硅材料、大尺寸碳化硅单晶、高纯金属及合金溅射靶材生产技术研发，加快高纯特种电子气体研发及产业化，解决极大规模集成电路材料制约；工信部出台的《重点新材料首批次应用示范指导目录（2021 版）》，将 8-12 英寸硅单晶抛光片、8-12 英寸硅单晶外延片确定为先进半导体材料；2020 年，国务院出台的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，从财税、投融资、研发开发、进出口、人才、知识产权、市场应用和国际合作八个方面制定相关政策，进一步优化集成电路产业的发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量；国务院 2016 至 2022 年历年政府工作报告中均明确提出了促进科技创新、发挥创新驱动等。国务院及各相关部委的相关政策支持为中国集成电路产业持续发展创造了良好的政策环境。

（3）芯片制造企业等积极扩产带动半导体硅片需求的增长

在终端应用市场的增长背景下，全球知名的晶圆代工厂商和 IDM 厂商等芯片制造企业开始加大投入扩大产能，台积电、三星、英特尔均推出了扩产计划。根据 SEMI 统计，到 2022 年全球将新扩建 29 座晶圆厂，其中 2021 年开始投建 19 座，2022 年开始投建 10 座。

中国大陆方面，以长江存储、合肥长鑫为代表的中国大陆存储器厂商也迅速扩产。此外中芯国际、华虹半导体、士兰微、华润微等晶圆代工厂及 IDM 厂商均在推进产能爬坡、扩产。以中芯国际为例，截至 2022 年 6 月末，中芯国际在上海、北京、深圳各有一座 12 英寸晶圆厂处于建设过程中。

受益于中国大陆芯片制造企业产能的扩充,并基于半导体产业链本土化的考虑,有望直接带动对国产半导体硅片需求的增长,国产半导体硅片出货面积有望加速提高。

(4) 12 英寸半导体硅片国产替代空间广阔

从硅片尺寸需求来看,当前 8 英寸、12 英寸半导体硅片需求旺盛。根据 SEMI 预测,保守预计 2020 年至 2024 年全球 8 英寸半导体硅片出货量增幅或高于 20%,12 英寸半导体硅片市场份额同样保持增长,2022 年市占率或增加至 70%。在中国大陆市场,12 英寸半导体硅片绝大部分均来自进口,目前中国大陆掌握且能实现 12 英寸半导体硅片量产的企业较少,12 英寸半导体硅片国产替代空间广阔。

九、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查

根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》(证监会公告[2018]22 号),本保荐机构就本次保荐业务中有偿聘请各类第三方机构和个人(以下简称“第三方”)等相关行为进行核查,具体情况如下:

1、本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查

本保荐机构在本次保荐业务中不存在各类直接或间接有偿聘请第三方的行为,不存在未披露的聘请第三方行为。

2、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查

本保荐机构对发行人有偿聘请第三方等相关行为进行了专项核查。经核查,发行人在律师事务所、会计师事务所等该类项目依法需聘请的证券服务机构之外,存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为。发行人还聘请了上海信公科技集团股份有限公司、北京旗渡锦程翻译有限公司和曾我法律事务所。

(1) 聘请的必要性

①上海信公科技集团股份有限公司:发行人与其签订相关服务协议,聘任其为发行人的募投项目完成行业及可行性研究报告。

②北京旗渡锦程翻译有限公司:发行人与其签订相关服务协议,聘任其为发行

人外文合同等文件完成翻译工作。

③曾我法律事务所：发行人与其签订相关服务协议，聘任其为发行人间接控股股东日本磁性控股及发行人子公司日本中欣出具境外法律意见书。

（2）第三方的基本情况、资格资质、具体服务内容

①上海信公科技集团股份有限公司：为第三方行业研究与投融资咨询机构，主要业务包括行业市场研究、投资咨询、上市并购再融资咨询。上海信公科技集团股份有限公司为发行人的募投项目完成行业及可行性研究报告。

②北京旗渡锦程翻译有限公司：为第三方翻译机构，主要业务包括翻译服务、版权代理等。北京旗渡锦程翻译有限公司为发行人外文合同等文件完成翻译工作。

③曾我法律事务所：为日本律师事务所，具有资格提供日本法律意见。曾我法律事务所为发行人间接控股股东日本磁性控股及发行人子公司日本中欣出具境外法律意见书。

（3）定价方式、实际支付费用、支付方式和资金来源

公司与第三方均通过友好协商确定合同价格，资金来源均为自有资金，支付方式均为银行转账。

截止本发行保荐书出具日，公司向上海信公科技集团股份有限公司实际支付服务费用为人民币 5.70 万元。公司尚未向北京旗渡锦程翻译有限公司实际支付服务费用（已产生服务费用 14.43 万元）。公司向曾我法律事务所实际支付服务费用为日币 885.93 万元。

3、核查结论

综上，本保荐机构在发行人本次发行上市项目中不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为。发行人在本次发行上市中除聘请保荐机构（主承销商）、律师事务所、会计师事务所、联席主承销商等依法需聘请的证券服务机构之外，还聘请了上海信公科技集团股份有限公司、北京旗渡锦程翻译有限公司和曾我法律事务所，除此之外不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为。发行人聘请其他第三方的行为合法合规，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险

防控的意见》（证监会公告[2018]22 号）的相关规定。

十、保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论

受杭州中欣晶圆半导体股份有限公司委托，海通证券股份有限公司担任其首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构。本保荐机构本着行业公认的业务标准、道德规范和勤勉精神，对发行人的发行条件、存在的主要问题和风险、发展前景等进行了充分的尽职调查和审慎的核查，就发行人与本次发行的有关事项严格履行了内部审核程序，并通过海通证券内核委员会的审核。

本保荐机构对发行人本次证券发行的推荐结论如下：

发行人符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件中关于首次公开发行股票并在科创板上市的相关要求，本次发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。杭州中欣晶圆半导体股份有限公司内部管理良好，业务运行规范，具有良好的发展前景，已具备了首次公开发行股票并在科创板上市的基本条件。因此，本保荐机构同意推荐杭州中欣晶圆半导体股份有限公司申请首次公开发行股票并在科创板上市，并承担相关的保荐责任。

附件：

《海通证券股份有限公司关于杭州中欣晶圆半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐代表人专项授权书》

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于杭州中欣晶圆半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之发行保荐书》之签字盖章页)

项目协办人签名： 张 力
张 力

保荐代表人签名： 李 凌 张博文 2022年8月18日
李 凌 张博文

保荐业务部门负责人签名： 姜诚君 2022年8月18日
姜诚君

内核负责人签名： 张卫东 2022年8月18日
张卫东

保荐业务负责人签名： 任 澎 2022年8月18日
任 澎

保荐机构总经理签名： 李 军 2022年8月18日
李 军

保荐机构董事长、法定代表人签名： 周 杰 2022年8月18日
周 杰

2022年8月18日
保荐机构：海通证券股份有限公司
2022年8月18日



海通证券股份有限公司关于杭州中欣晶圆半导体股份有限
公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐代表人专项授权书

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及有关文件的规定，我公司指定李凌、张博文担任杭州中欣晶圆半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐代表人，负责该公司股票发行上市的尽职保荐和持续督导等保荐工作事宜。项目协办人为张力。

特此授权。

保荐代表人签名：  
李 凌 张博文

保荐机构法定代表人签名： 
周 杰

保荐机构：海通证券股份有限公司

2022年8月18日